

广东德豪润达电气股份有限公司
关于深交所对公司关注函《中小板关注函【2019】第 143 号》
的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东德豪润达电气股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第 143 号)(以下简称“《关注函》”)，《关注函》的内容如下：

2019 年 2 月 12 日，你公司披露《关于无法按期归还募集资金的公告》称，你公司于 2018 年 2 月 12 日召开董事会、监事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意你公司使用不超过 90,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。由于你公司现金流紧张，截至 2019 年 2 月 11 日，上述暂时补充流动资金的募集资金 90,000 万元未归还至你公司募集资金专户。

此外，根据你公司 2018 年 12 月 22 日披露的《关于募集资金账户异动情况的公告》，你公司募集资金账户中 8.5277 亿元分别被银行强制划扣及被你公司自行挪用。

我部对上述情况高度表示关注。请你公司认真核查并补充披露以下内容：

- 1、你公司归还上述募集资金的还款计划；
- 2、你公司非公开发行募投项目的实施进展情况，上述募集资金违规行为是否影响到募投项目的实施以及上述事项对你公司生产经营的影响。

3、你认为需要说明的其他事项。

本公司已按深圳证券交易所的要求对《关注函》进行了回复，现将对《关注函》的回复公告如下：

问题 1：你公司归还上述募集资金的还款计划。

答复：

一、公司于 2018 年 12 月 22 日披露了《关于募集资金账户异动情况的公告》（公告编号：2018-129），公司募集资金出现异动的金额为 8.5277 亿元。

二、公司于 2019 年 2 月 12 日发布了《关于无法按期归还募集资金的公告》，因相关客观及主观原因，公司无法按期归还暂时补充流动资金的募集资金 9 亿元。

针对上述异动的募集资金 8.5277 亿元及无法按期归还的暂时补充流动资金的募集资金 9 亿元合计 17.8577 亿元，公司短期内无法归还，有以下原因：

1、外部融资的影响

2018 年下半年，中美贸易争端未能平息，国际、国内宏观经济环境发生重大不利变化，国内 A 股市场持续向下震荡，公司股票价格在短时期内亦出现较大幅度下跌。由于公司大股东所持股票存在较高比例质押融资情形，股价的向下波动致使其股票存在被冻结、甚至存在被动减持的风险。截止目前，公司股价仍处于相对低位。

由于公司向银行的贷款融资基本上均由大股东提供信用担保，股价下跌使大股东的信用担保能力出现危机，对其为公司贷款提供的担保信用产生重大影响；而当时宏观环境亦出现进一步紧张的趋势，市场资金十分紧张，银行为回避风险不断向本公司催收贷款，采取缓贷、缩贷、抽贷的措施，为此甚至扣划了公司募集资金。公司的银行贷款规模从 2018 年初约 48 亿元，下降至 2018 年末的约 18 亿元。

针对上述情况，公司采取了包括但不限于通过追加实物抵押等相关增信措施维持存量授信、加强与银行的沟通、谈判、积极协商新增贷款等，但是，公司的贷款规模与 2018 年初的 48 亿元相比仍大规模减少。截止 2019 年 2 月末，公司的

银行贷款规模仅为约 14.9 亿元。

2、公司经营业绩的影响

由于宏观经济环境的不利变化、以及公司自身原因等的综合影响，公司 2018 年度的经营成果不太乐观。公司于 2019 年 2 月 28 日发布了《2018 年度业绩快报》，2018 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-50,282.48 万元，并且该业绩快报的数据尚未包含 Lumileds 诉讼可能给公司业绩带来的负面影响，以及尚未包含 LED 芯片资产可能存在减值给公司业绩带来的负面影响。公司经营状况的不利变化反过来也一定程度上影响了向银行申请融资的能力。

2018 年内，在面临经营环境较大不利变化的情况下，为了保证公司生产经营活动的正常进行，公司管理层采取了包括但不限于盘活存量资产（例如拟出售珠海盈瑞节能科技有限公司股权）、加强对应收款项的回收力度、通过追加实物抵押等相关增信措施，维持存量授信，并与其他银行积极协商新增贷款、加大对库存产品的处理的力度，对部分产品执行降价促销的政策等措施，加大公司现金回笼，确保公司不出现资金链断裂的风险。

虽经上述回笼现金的努力，但结合公司目前生产经营的实际情况，并经管理层、财务部门核算，公司短期内无法归还上述合计 17.8577 亿元的募集资金。

问题 2：你公司非公开发行募投项目的实施进展情况，上述募集资金违规行为是否影响到募投项目的实施以及上述事项对你公司生产经营的影响。

答复：

一、项目的进展情况

公司对蚌埠基地LED倒装芯片项目的筹备、投资最早开始于2014年，详见公司分别于2014年1月15日、12月9日在指定信息披露媒体上发布的《关于设立子公司暨对外投资的公告》（公告编号：2014-06）、《关于蚌埠 LED 产业基地投产的提示性公告》（公告编号：2014-86）。为了满足蚌埠基地LED倒装芯片的封装要求，公司于2015年配套规划了大连基地的芯片级封装项目。

公司将LED倒装芯片项目、LED芯片级封装项目作为募投项目的非公开发行股票预案提出于2015年6月，后因当时国内证券市场发生了较大变化，同时综合考虑

当时资本市场环境和公司业务发展规划等因素，公司于2016年3月决定终止2015年非公开发行股票事项，随后于2016年4月重新提出新的方案，新的方案缩减了募资总额，但募集资金投资项目和产能规划等未发生变化。

根据公司于2016年4月15日在指定信息披露媒体上发布的《2016年度非公开发行股票预案》、《2016年度非公开发行可行性研究报告》，公司对募投项目的投资、产能规划如下：

序号	项目名称	计划投资 (万元)	拟用募集资金 投入(万元)	规划的产能	
1	LED倒装 芯片项目	250,000	150,000	50万片/年	按每片外延片可加工成倒装芯片10000颗算，可加工成芯片50亿颗/年，合格率按85%算，年产倒装芯片(合格品)42.5亿颗。
2	LED芯片 级封装项目	150,000	50,000		满足42.5亿颗/年倒装芯片产量的封装需求，形成芯片级封装器件42.5亿颗的生产能力
合计		400,000	200,000		

经公司及相关方的共同努力，该非公开发行股票事项于2017年10月完成，新增股票于2017年11月6日上市。募集资金到位后公司根据市场、订单及公司的实际情况把控募集资金投入的进度。

截止2018年12月末，公司使用募集资金对项目的投入情况如下（未经审计）：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2018年12月末累计 投入募集资金金额	投入进度(%)
LED 芯片级封装	49,227.50	1283.00	2.61%
LED 倒装芯片项目	147,682.48	20478.12	13.87%
承诺投资项目小计	196,909.98	21761.12	11.05%

LED 倒装芯片项目、LED 芯片级封装项目取得有关部门同意备案的时间分别为2014年5月、2015年7月，在非公开发行股票募集资金到位前，为抓住市场机遇，

公司已经使用部分自有资金以及银行贷款投入募投项目，用于建设厂房、产线、购买设备等，本项目的募集资金到位后公司已经将符合置换要求的先期投入资金进行相应置换。

经统计，自项目获得有关部门同意备案至 2018 年末，公司通过自有资金、银行贷款、募集资金等方式对两个项目的总投资（以在建工程、固定资产等的增加额为统计口径），以及形成的产能如下（未经审计）：

序号	项目名称	计划投资（万元）	募集资金承诺投资总额（万元）	累计已投入金额（万元）	形成的产能	累计实现的效益
1	LED倒装芯片项目	250,000	147,682.48	238,677.22	60万片/年 按前述规划每片外延片可加工成倒装芯片10000颗算，可加工成芯片60亿颗/年	-3408万元
2	LED芯片级封装项目	150,000	49,227.50	11,737.96	封装器件产能60亿颗/年	-4799万元
合计		400,000	196,909.98	250,415.18		-8207万元

关于上述投资及产能的情况，说明如下：

1、LED 芯片级封装项目累计投入 11,737.96 万元，形成 60 亿颗/年的封装产能，主要有三个方面的原因：一方面是，半导体技术迭代速度迅猛，在募集资金尚未到位前，公司根据市场需求的快速变化，对部分正装器件产能设备进行了通用性改造，该方法节约投资的同时，可较快形成较大的产能；另一方面是，相比项目规划时期，芯片级封装项目的工艺路线、技术水平已大幅提升，例如：项目规划时期工艺是金锡共晶路线，到公司实际投入生产时采用的工艺已经是锡膏方案；第三，国产设备的崛起带来设备价格降低的同时，也提升了加工能力，提高了投入产出比。

2、LED 倒装芯片在技术上具有单位面积的发光亮度高、瞬间过载电流大、芯片体积小等众多优点，是相对于 LED 正装技术而言，新的技术路线。但在实现产业化过程中，由于 LED 倒装芯片工艺制程复杂、设备要求精度高、设备投资大等原因，使得 LED 倒装芯片单位成本较正装芯片高，售价高，进而影响到市场推广、市场占有率的提升。

鉴于上述客观原因，以及本公司市场开拓能力不足等原因，公司 LED 倒装芯片的市场占有率不及预期，对成本的摊销力度不大，造成该项目效益不理想，处于亏损状态。公司形成的上述倒装产能实际上是高于公司的倒装订单需求的。

鉴于倒装的实际产量是根据订单的情况来制定的，为了减少产能的闲置，公司目前有将倒装的部分产能用于生产市场情况更好的正装芯片的情况。

三、结合目前 LED 芯片的整体市场情况以及公司的实际情况，公司正在研究、评估是否终止使用募集资金继续对募投项目进行投入，并将尚未投入项目的资金的用途进行变更

由于公司的募投项目分别于 2014 年、2015 年获得有关部门的备案，至 2017 年募集资金到位时，时间跨度已相对较大。在此期间，LED 行业的市场情况也在发生较大变化，主要体现在以下方面：

1、LED 设备价格在下降，但单机效率在提升，行业进入门槛在降低

由于技术升级、市场供需关系、国产设备崛起等的影响，LED 设备的性价比已经有较大提升，体现在设备价格下降，但是单机效率在提升，从而使得行业的投资成本在降低，同等的产能所需的投资亦有所降低，但同时也降低了行业的进入门槛。

芯片核心设备 MOCVD 的价格及产能情况

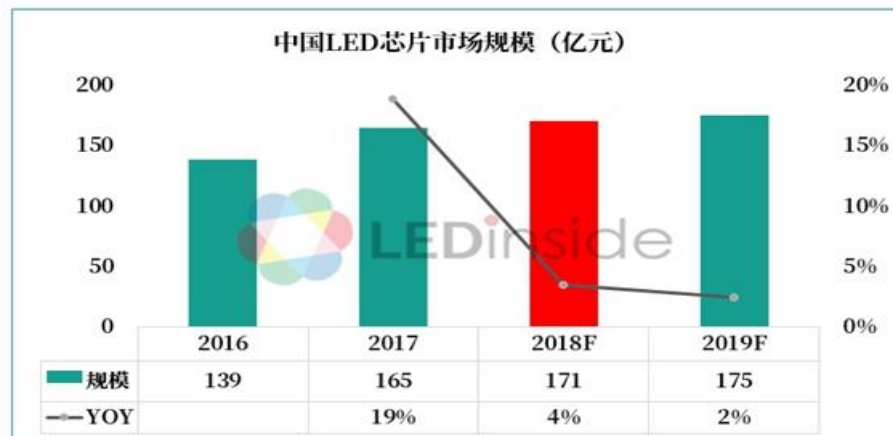
设备型号	采购年份	价格 (万元/腔)	单腔容量	年产能 (万片)	摊销成本 (元/2寸片)
K465 (veeco)	2008	1400	45片2寸	7.5	23
K465i (veeco)	2011	1400	54片2寸	9	19
RB (veeco)	2015	1600	31片4寸	20	10
EPIK 868(veeco)	2017	1200	33片4寸	21	7
A7 (中微)	2017	800	34片4寸	21	5

资料来源：华创证券《LED 行业深度研究报告》

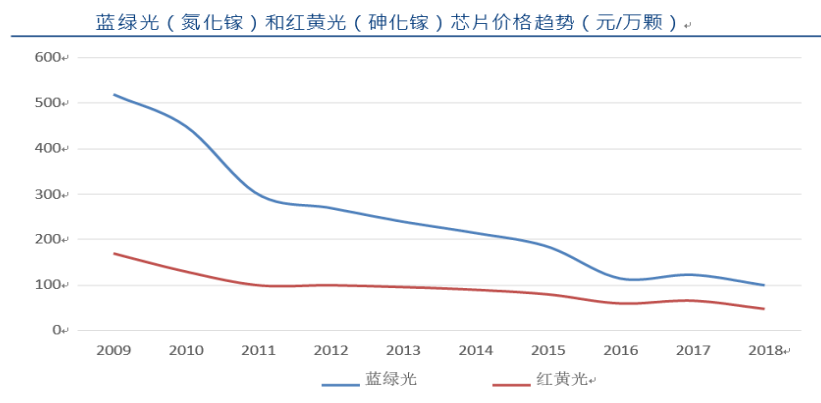
2、LED 芯片行业持续扩张，产能快速释放导致产能过剩，导致 LED 芯片价格持续下跌

受国家对半导体行业鼓励政策、市场需求、以及设备价格下降等的影响，LED 芯片国内厂商持续扩产，产能的快速释放导致产能过剩。

据 LEDinside 统计：“2018 年中国 LED 芯片市场规模达到 171 亿人民币，同比仅成长 4%，相较于 2017 年的 19%，增速下降明显。2017 年下半年开始，厂商的产能持续释放，截止 2018 年底，大陆 LED 芯片厂商总产能达到 1120 万片/月（折合 2 寸），同比增长 31%。产能增速高于需求增速，导致厂商库存居高不下，芯片价格持续下跌。同时，其预计 2019 年 LED 芯片产能仍会增加 140 万片/月（折合 2 寸），目前厂商库存已经处于较高水位，随着 2019 年新产能的释放，芯片市场价格预计仍会继续下跌”。



数据来源: LEDinside



数据来源: 华创证券《LED 行业深度研究报告》中整理的来自 wind 的资料

3、宏观环境变差、房地产调控、限购及汽车行业、智能手机行业增长乏力等，使得 LED 芯片下游需求有所减少，进一步导致了 LED 芯片价格的下跌



数据来源: wind



数据来源: wind



数据来源: wind

由于 LED 倒装芯片体积小、发光效率高等特点，其主要应用于手机闪光灯、汽车大灯及其他大功率照明产品等。鉴于上述 LED 芯片行业的整体情况，以及 LED

倒装芯片的下游手机、汽车等市场不太乐观的情况，同时综合考虑以下因素：

- 1、公司的募投项目实际形成的产能已满足目前公司的订单需要；
- 2、募投项目盈利能力不佳，处于亏损状态，继续投入不符合公司及股东的利益；
- 3、目前公司所采取的回笼现金的措施主要是为了保证生产经营的正常进行，以确保公司不出现资金链断裂的风险；
- 4、被扣划和暂时补充流动资金的募集资金也是公司自有资金的一部分，目前将该部分资金归还至募集资金账户的主要渠道将是外部融资；
- 5、目前的金融环境导致融资的难度和成本均在提升，通过外部融资归还募集资金，将进一步提高公司的融资压力和成本；

因此，公司正在研究、评估是否终止使用募集资金继续对募投项目进行投入，并将尚未投入项目的资金的用途进行变更。

四、募集资金被扣划等事项对募投项目实施及公司生产经营的影响

募集资金被扣划后，在 2018 年整体金融环境收紧的情况下，加剧了公司营运资金紧张的局面。

经财务部门统计，截止目前，募投项目应付的设备、厂务款项约为 1.57 亿元。募集资金被扣划后，影响了上述款项的支付进度。目前，上述设备、厂务正常使用，公司也在积极采取回笼现金的措施及时支付上述款项，以避免款项未能及时支付可能引发的不利影响。

问题 3：你公司认为需要说明的其他事项。

答复：

公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司的相关信息均以在上述媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇一九年三月十五日